

## 越南教育與培訓部舉辦半導體芯片產業研討會（1）

駐越南代表處教育組

教育與培訓部（MOET）於 2023 年 10 月 19 日在峴港大學舉辦越南高等教育機構半導體芯片產業高素質人力資源開發研討會。

出席者有教育與培訓部領導、計畫投資部、科技部、資訊通訊部代表、峴港市領導代表、近 40 所具大規模符合、接近半導體芯片設計專業領域科系之越南高等教育機構代表、半導體芯片設計領域的國內外企業代表以及多名半導體芯片產業專家。

研討會旨在凝聚全國一流高校的共識和決心，重視、投入，建立國家政策機制，積極配合，推動地方和企業培養高素質人才，為發展國家半導體芯片產業服務。

會上，高等教育司向參加研討會代表報告關於越南高等教育機構系統中半導體芯片產業培訓人力資源的現況和方向。同時，聽取大學、學院、企業、專業領域專家的建議及教育與培訓部領導提出的方向發言。

值此之際，河內國家大學、胡志明市國家大學、峴港大學、河內工業大學、郵政電信技術學院等 5 所高等教育機構將共同簽署合作備忘錄，以促進潛力、優勢、與越南高等教育機構統一行動計劃，做好準備，確保和提高人力資源培訓品質和有效性，優質資源，滿足半導體產業發展的需求；同時促進科學研究、技術轉移和創新，從現在到 2030 年，並展望 2045 年，與全球半導體芯片價值鏈中的半導體企業進行有效合作；同意與政府提出機制和政策，以發展學習者數量並在高等教育機構中創建半導體專家團隊。

（未完待續）

撰稿人/譯稿人：陳鈺瓊

資料來源：<https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8811>